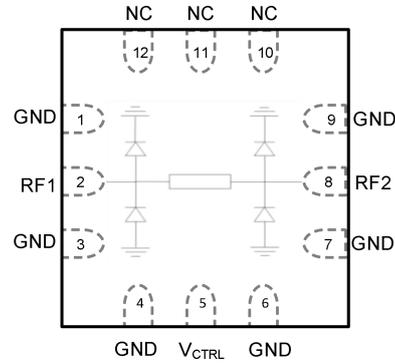




主要特点

- 工作频段: DC – 6 GHz
- 插损: 1.2 dB
- 限幅功率: 27-33 dB
- 耐功率: +43 dBm CW (输入端)
- 塑封尺寸: 12 Lead, 3mm×3mm QFN

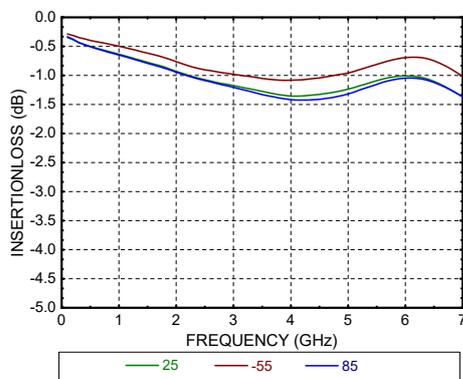
功能框图



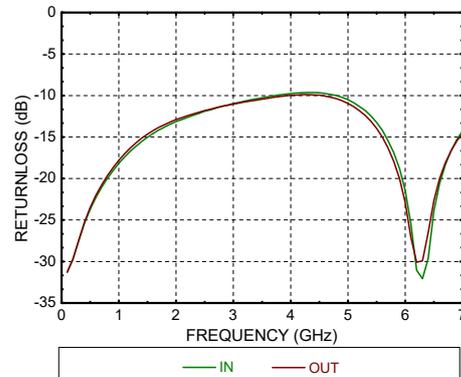
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, 50Ω)

参数	条件	最小	典型	最大	单位
插损	0.1GHz~2.0GHz		0.7		dB
	2.0GHz~4.0GHz		1.1	1.3	dB
	4.0GHz~6.0GHz		1.3	1.4	dB
限幅电平	1G	VCTRL=0V		27	dBm
		VCTRL=-0.5V		28	dBm
		VCTRL=-1.5V		30	dBm
	6G	VCTRL=0V		31	dBm
		VCTRL=-0.5V		32	dBm
		VCTRL=-1.5V		33	dBm
回波损耗	0.1GHz~6.0GHz		-10		dB

插损 vs. 温度

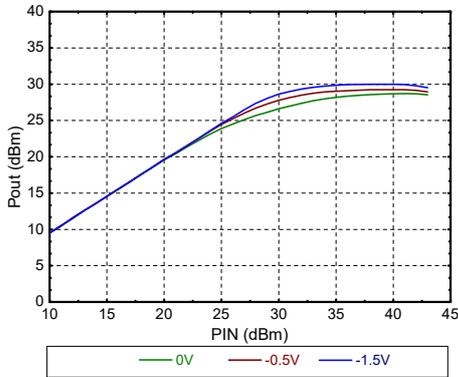


回波损耗

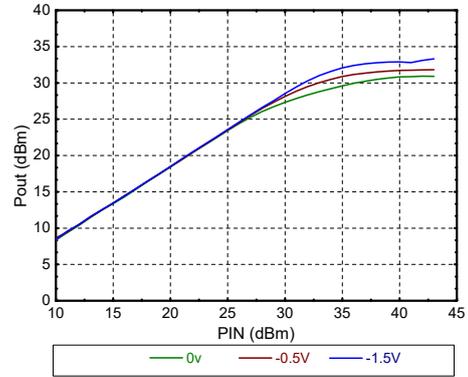




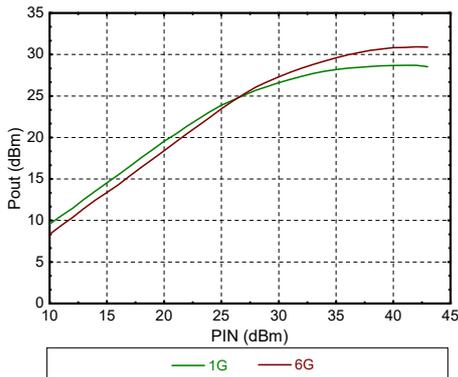
Pout VS Pin @1G



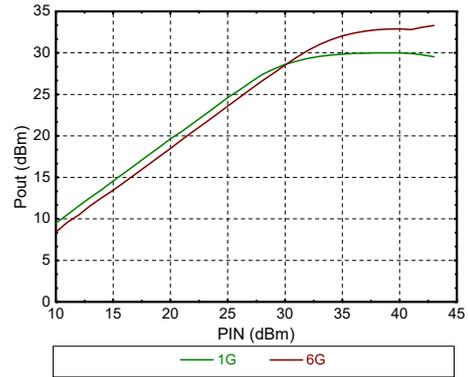
Pout VS Pin @6G



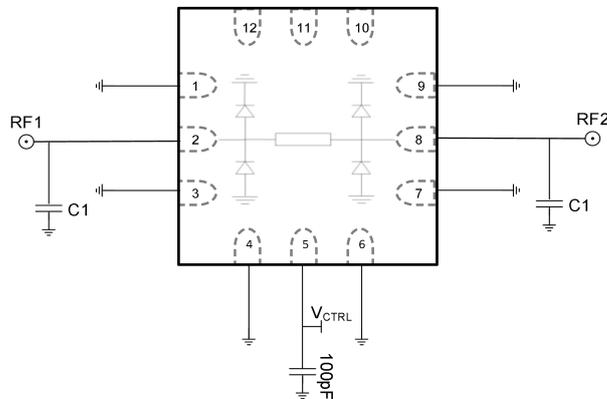
Pout VS Pin @ 0V



Pout VS Pin @ -1.5V



应用框图



名称	描述
C1	0.3pF, 0402 或 0603 封装电容

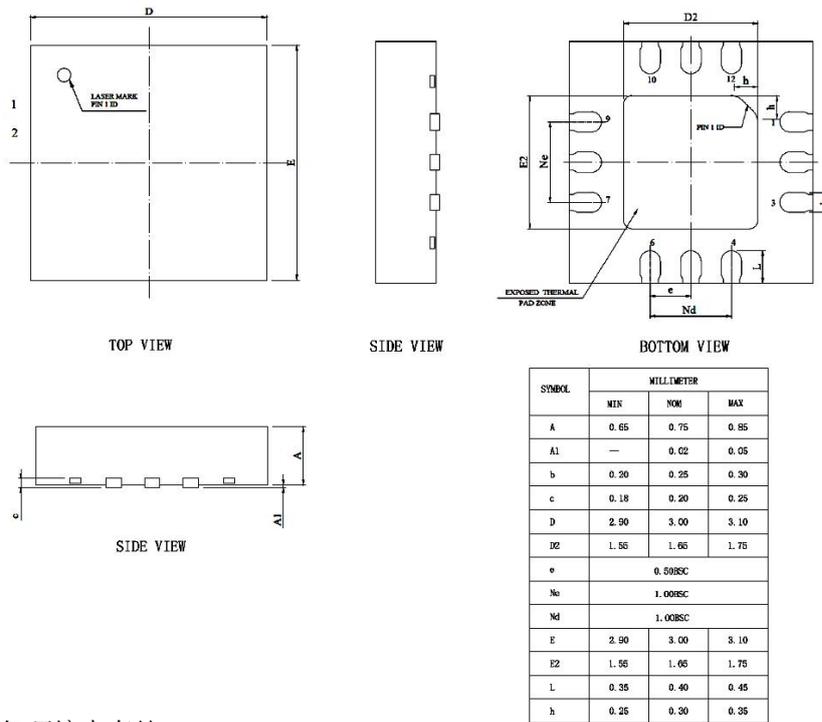


引脚说明

引脚序号	功能	引脚说明
2	RF1	射频输入引脚, DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容。
8	RF2	射频输出引脚, DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
5	V _{CTRL}	该引脚是控制引脚, 需外接 100pF 去耦电容。
1, 3, 4, 6, 7, 9	GND	必须连接至 RF/DC 地
其余	NC	悬空, 建议接地
底部中央焊盘	GND	底部中央焊盘必须连接至 RF/DC 地。

物理参数

单位: mm



注意事项:

1. 器件在干燥、氮气环境中存储;
2. 器件对静电敏感, 在储存、运输、储存、装配和使用过程中注意防静电;
3. 所有接地引脚请连接RF/DC地;
4. 该产品适用于回流焊贴装工艺, 回流焊温度 $\leq 215^{\circ}\text{C}$, 焊膏融化时间不超过1min;
5. 本器件热耗较高, 器件使用时, PCB设计应充分考虑散热, 确保器件稳定工作, 必要时可联系供应商。

极限参数

参数	备注	数值	单位
控制电压	V _{CTRL}	-1.5~2.5	V
射频输入功率	输入端	43(CW)	dBm
存储温度	-	-55~150	$^{\circ}\text{C}$
工作温度	-	-40~85	$^{\circ}\text{C}$